

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：芯碁微装

股票代码：688630

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	长江证券、浙商证券、开源证券、永赢基金、财通基金、展博投资
时间	2026年7月7日
地点	合肥芯碁微电子装备股份有限公司1号楼
公司接待人员姓名	总经理：方林 董事会秘书、财务总监：魏永珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司总经理方林先生、董事会秘书兼财务总监魏永珍女士针对公司近期经营情况进行解读。</p> <p>公司执行“PCB+泛半导体”双轮驱动战略，目前来看PCB和泛半导体各项业务下游需求都非常旺盛；PCB业务包含PCB曝光设备和激光钻孔设备两大板块，受益于下游PCB厂商CAPEX的持续增长，PCB设备新签订单持续增长，公司产能利用率维持在较高水平。</p> <p>泛半导体业务包含IC载板和先进封装两个业务板块，IC载板受益于下游ABF载板、BT载板需求的恢复，以及类载板（SLP）需求的增加，整体处于供不应求的状态；先进封装业务受益于国内CoWoS-L以及类CoWoS-L的扩产，整体订单充足。</p> <p>二、问答环节。</p> <p>1、公司今年新签订单的情况有何更新？</p>

答：今年一季度公司新签订单超过 8 亿元，Q2 新签订单维持 Q1 的高增长态势，在手订单充足。

2、PCB 曝光设备的市占率是多少？

答：芯碁成立之初就深耕直写光刻技术，2024 年首次成为全球第一的 PCB 直写光刻设备供应商，市占率为 15%；2025 年随着 AI 服务器、数据中心等需求的爆发，芯碁市占率稳步提升，根据灼识咨询数据，芯碁 2025 年 PCB 曝光机市占率为 18.8%。凭借在高端曝光设备上的技术优势，未来市占率预计会进一步提升。

3、PCB 曝光设备的均价有何变化，今年单价是否会提升？

答：2025 年 PCB 曝光设备收入约为 10.8 亿元，销售量为 475 台，均价约为 227 万元/台；今年随着高端机型出货占比的提升，均价预计会稳步提升。

4、激光钻孔设备在客户端的验证结果及未来的产品规划？

答：公司激光钻孔设备规划有 CO2 激光钻孔设备、UV 光激光钻孔设备以及超快激光钻孔设备；2025 年 12 月 CO2 激光钻孔设备通过客户量产验证，今年目标是实现小批量交付，上半年已交付的 CO2 激光钻孔设备在客户端表现良好，已获得客户的重复批量订单；随着量产经验的不断积累，公司预计在今年下半年将 CO2 激光钻孔设备送往下游第一梯队客户验证。

5、载板设备供不应求的原因是什么？

答：首先下游的 ABF 载板、BT 载板的需求在持续向好，光模块、CoWoP 技术所用的类载板（SLP）需求也在上升，下游厂商扩产意愿增加，带动设备需求增长。此外载板领域的国产替代也在加速，芯碁经过多年的技术沉淀，设备性能已经比肩甚至超越海外设备厂商，加上芯碁采用

	<p>标准化和定制化并行的生产方式，设备交付周期仅为海外厂商的一半，充分受益本轮载板领域的国产替代。</p> <p>6、载板设备的价格和毛利率情况？</p> <p>答：载板设备价格带比较宽，新品 2 微米的载板设备价格是千万元级别，毛利率可参考公司泛半导体业务的毛利率。</p> <p>7、先进封装设备具体应用于什么环节，下游客户有哪些？</p> <p>答：主要应用于 CoWoS-L 的中介层曝光，下游客户包含长电、通富、甬矽等国内头部封装厂，目前均已完成设备的导入，未来随着更多下游厂商加入 CoWoS-L 的扩产，芯碁的下游客户群体会持续扩大。</p> <p>8、直写光刻技术在 CoPoS 中有何应用？</p> <p>答：随着芯片尺寸变大，为提升使用效率，中介层由 Wafer Level 变成 Panel Level，板级相对于晶圆级更容易发生偏移和翘曲；此外芯片尺寸变大，中介层需要嵌入的硅桥数量变多，直写光刻具有智能纠偏、智能再布线的技术特点，在 CoPoS 中的优势更加明显。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-7-7